

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 3 区分
【発行日】平成 16 年 9 月 9 日 (2004.9.9)

【公開番号】特開 2002-280809 (P2002-280809A)
【公開日】平成 14 年 9 月 27 日 (2002.9.27)
【出願番号】特願 2001-81276 (P2001-81276)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 P 5/107

H 0 5 K 9/00

【F I】

H 0 1 P 5/107 B

H 0 5 K 9/00 Z

H 0 5 K 9/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 8 月 26 日 (2003.8.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

高周波部品が取り付けられる第 1 の導電性ブロックと、
前記高周波部品に接続されるマイクロストリップラインが形成される誘電体基板と、
この誘電体基板を挟んで前記第 1 の導電性ブロックと対向して取り付けられる第 2 の導電性ブロックとを具備し、
前記第 1 の導電性ブロックに導波管部を形成し、
前記第 2 の導電性ブロックに、前記マイクロストリップラインに励振された高周波信号を電波に変換するためのバックショート部を形成し、
前記第 1 または第 2 の導電性ブロックのうち少なくとも一方に、全体で前記高周波部品を収容可能なサイズの空間部を形成し、
前記マイクロストリップラインを挟んで前記導波管部と前記バックショート部とを対向させ、前記空間部に前記高周波部品が収容されるように、前記誘電体基板を前記第 1 および第 2 の導電性ブロックで挟持して固定したことを特徴とする高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造。

【請求項 2】

前記空間部と前記バックショート部とを結合する、前記電波の波長よりも狭いトンネル構造を有することを特徴とする請求項 1 に記載の高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造。

【請求項 3】

前記高周波部品と前記誘電体基板とが同一平面上に重なる場合に、前記高周波部品を避けるためのスペースを前記誘電体基板に形成したことを特徴とする請求項 1 に記載の高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造。

【請求項 4】

前記高周波部品は、前記第 1 の導電性ブロックに接触するように形成された回路グランドを備えることを特徴とする請求項 1 に記載の高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造。

【請求項 5】

前記誘電体基板は、前記第 1 または第 2 の導電性ブロックの少なくとも一方に接触するように形成された基板グラウンドを備えることを特徴とする請求項 1 に記載の高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造。

【請求項 6】

前記第 1 および第 2 の導電性ブロックを、導電性部材を介して接続したことを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明に係わる高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造は、高周波部品が取り付けられる第 1 の導電性ブロックと、マイクロストリップラインが形成される誘電体基板と、この誘電体基板を挟んで前記第 1 の導電性ブロックと対向して取り付けられる第 2 の導電性ブロックとを具備し、前記第 1 の導電性ブロックに導波管部を形成し、前記第 2 の導電性ブロックに、前記マイクロストリップラインに励振された高周波信号を電波に変換するためのバックショート部を形成し、前記第 1 または第 2 の導電性ブロックのうち少なくとも一方に、全体で前記高周波部品を収容可能なサイズの空間部を形成し、前記マイクロストリップラインを挟んで前記導波管部と前記バックショート部とを対向させ、前記空間部に前記高周波部品が収容されるように、前記誘電体基板を前記第 1 および第 2 の導電性ブロックで挟持して固定したことを特徴とする。

好ましくは、前記高周波部品に、前記第 1 の導電性ブロックに接触するように回路グラウンドを形成するとよい。

好ましくは、前記誘電体基板に、前記第 1 または第 2 の導電性ブロックの少なくとも一方に接触するように基板グラウンドを形成するとよい。

好ましくは、前記第 1 および第 2 の導電性ブロックを、導電性部材を介して接続するとよい。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明に係わる高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造の実施の形態を示す断面図。

【図 2】図 1 に示された高周波部品及び高周波伝送路変換回路の一体化構造のより詳細な断面図。

【符号の説明】

- 1 ... 基板
- 2 ... 高周波部品
- 3 ... 導波管ブロック
- 4 ... カバー
- 5 ... 導波管部
- 6 ... バックショート部
- 7 ... トンネル構造
- 9 ... マイクロストリップライン
- 10 ... 基板グラウンド
- 11 ... 回路グラウンド

1 2 ... 固定ネジ

1 3 ... 空間部

【手続補正 4】

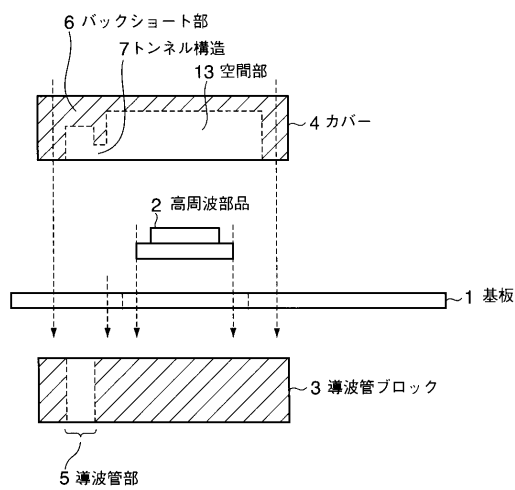
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 1】



【図 2】

